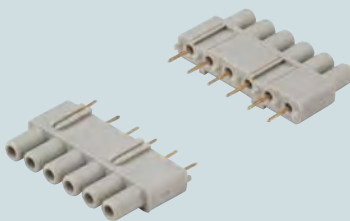


passende Einsätze:

	Seite:
CDD24 polig + ⊕	67
CDD 42 polig + ⊕	69
CDD 72 polig + ⊕	70
CDD 108 polig + ⊕	72
CX 8/24 polig + ⊕	169
CX 6/36 polig + ⊕	170
CX 12 (MIXO) 12 polig	194

Interfacemodul zur Leiterplattenanbindung



Versilberte oder vergoldete Kontakte 6A



Beschreibung	Artikelbezeichnung	Artikelbezeichnung	Artikelbezeichnung
--------------	--------------------	--------------------	--------------------

Interfacemodul mit 6 vergoldeten Buchsenkontakten
- für Leiterplattenanbindung, Durchmesser max. 2,4 mm
Interfacemodul mit 6 versilberten Buchsenkontakten
- für Leiterplattenanbindung, Durchmesser max. 2,4 mm

CIF 2.4

CIF 2.4 A

Buchsenkontakte 6A für Buchseneinsätze
mit Verbindungsstift Ø 1 mm

CDFA 6A

versilbert

CDFD 6A

vergoldet

Stiftkontakte 6A für Stifteneinsätze
mit Verbindungsstift Ø 1 mm

CDMA 6A

CDMD 6A

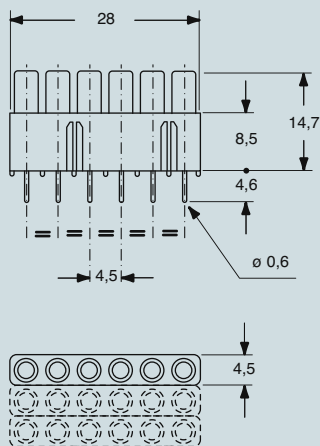
Anwendung des Interfacemoduls

Die Interfacemodule CIF werden – je nach Polzahl des betreffenden Kontakteinsatzes – zu einem Modulblock zusammengesetzt.

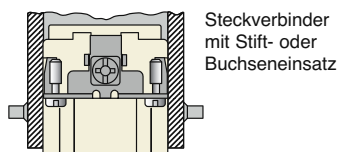
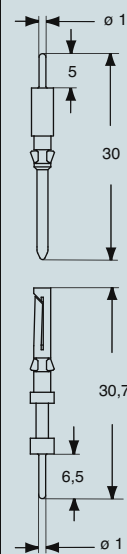
Einsätze der Serie	Polzahl	Anzahl der CIF-Module
CDD	24	4
CDD	42	7
CDD	72	12
CDD	108	18
CX	8/24	4
CX	6/36	6
CX (MIXO)	12	2

Der Modulblock wird auf die Leiterplatte gelötet und kann anschließend mit einem entsprechenden Kontakteinsatz (Buchse oder Stift) gesteckt werden.

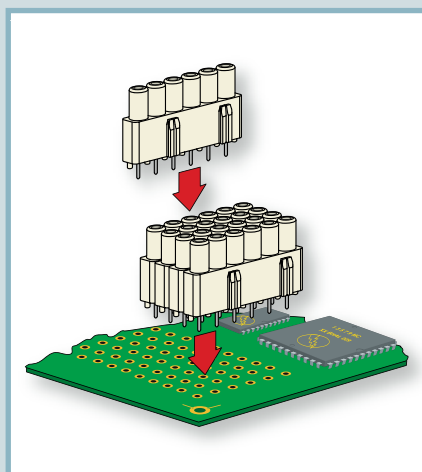
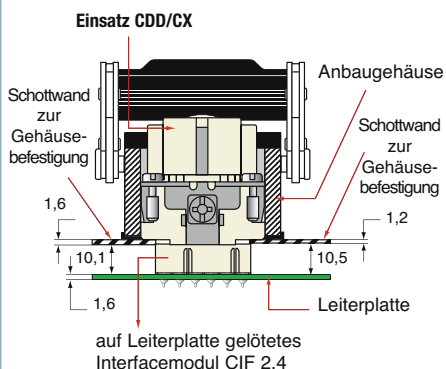
Abmessungen in mm



Abmessungen in mm



Steckverbinder mit Stift- oder Buchseneinsatz



Die angegebenen Abmessungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

